# **CURRICULUM VITAE**

#### Alberto Octavio Manzanares

Fecha de nacimiento: 20/07/1981 Domicilio: C/ Alicante, 31, 5°D.

Población: Madrid

C.P.: 28045

Provincia: Madrid

Teléfono: +34 676169834

e-mail: alberto.ocma@gmail.com



### Datos académicos

01/09/2005 – 21/12/2009 Doctor Ingeniero Industrial (con mención europea)

en la Universidad Politécnica de Madrid.

01/10/2002 – 10/09/2004 Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial

en la Universidad Pontificia Comillas (ICAI) en

Madrid.

01/10/1999 – 15/06/2002 Ingeniería Técnica Industrial (Electrónica

Industrial) en la Universidad Pontificia Comillas

(ICAI) en Madrid.

# Experiencia profesional

01/02/2011 – 31/08/2013 Docente e investigador en la Universidad de

Castilla-La Mancha.

Función: Responsable principal de la sala blanca orientada

a la fabricación de microtecnología del Instituto de

Nanociencia, Nanotecnología y Materiales Moleculares (INAMOL) (Gestión en contacto

directo con los proveedores y clientes, mantenimiento de los equipos y uso de las instalaciones). Diseño, fabricación y simulación de dispositivos MEMS (micro electromechanical

systems) para aplicaciones de sensores y

transductores.

Docente de laboratorio de instrumentación

electrónica (LabVIEW y circuitos de

instrumentación).

Docente de laboratorio de electrónica digital.

01/03/2010 – 31/12/2010 Investigador en el Centro de Acústica Aplicada y

Evaluación no Destructiva (CAEND) UPM-CSIC (proyecto ICARO del marco CENIT asignado a

Airbus y CSIC).

Función: Diseño, simulación, fabricación y caracterización

de transductores ultrasónicos capacitivos

micromecanizados (CMUT) resonantes para la evaluación no destructiva en aire de defectos en

composites avanzados.

01/09/2005 – 31/08/2009 Investigador (Beca más contrato FPI) en el

Instituto de Acústica-CSIC.

Función: Estudio, diseño, simulación, fabricación y

caracterización de CMUTs para aplicaciones de

ensayos no destructivos en aire.

01/06/2005 – 31/08/2005 Investigador en el Instituto de Acústica-CSIC

(contrato asociado a Gamesa y Tecnatom).

Función: Realización de ensayos no destructivos en

estructuras tipo placa empleadas en aeronáutica y mejoras en el desarrollo del programa para la obtención de imágenes de estructuras empleando

técnicas de apertura sintética.

01/03/2004 – 31/08/2004 Desarrollo del Proyecto Fin de Carrera en el

Instituto de Acústica-CSIC.

Función: Diseño y fabricación de amplificador de bajo ruido

para mejorar las señales en recepción de un sistema de inspección por ultrasonidos y desarrollo de un programa para la formación de imágenes de estructuras tipo placa mediante

técnicas de apertura sintética.

# Estancias en centros en el extranjero

01/09/2006 – 01/11/2006 Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di

Ingegneria Elettronica, Roma (Italia).

Función: Simulación por el método de los elementos finitos

(ANSYS) de CMUTs acoplados a un fluido.

01/09/2007 – 01/11/2007 University of Warwick – School of engineering.

Coventry (Reino Unido).

Función: Caracterización acústica de transductores

ultrasónicos capacitivos.

01/09/2008 – 21/12/2008 University of Strathclyde – Center for Ultrasonic

Engineering, Glasgow (Reino Unido).

Función: Simulación de transductores CMUT con PZFlex,

simulación de la propagación de onda y

caracterización acústica y por vibrometría de un array lineal CMUT para evaluación no destructiva.

08/05/2013 – 29/05/2013 Vienna University of Technology - Viena (Austria).

Función: Fabricación de microcantilevers en sala blanca.

### Idiomas

Español Nativo Inglés Nivel alto Italiano Nivel medio

# Patentes, publicaciones y participación en proyectos

Patente: Transductor Capacitivo Utrasónico Micromecanizado con cavidades resonantes y sus aplicaciones en aire (P 200802498)

4 artículos en revistas indexadas en el SCI.

16 contribuciones a congresos internacionales.

Participación en 3 proyectos financiados en convocatorias públicas y 6 proyectos con empresas.

## Herramientas informáticas

Aplicaciones Microsoft Office, Matlab/Simulink, AutoCAD, Multisim,

PSPICE, ORCAD, Photoshop, ...

Programación LabVIEW, C, Matlab, Ensamblador, VHDL

Elementos Finitos ANSYS, PZFlex, Coventor Sistemas Operativos Windows, Mac Os X, DOS

#### Otros datos

Permiso de conducir B